

Chipfabrik Microelectronic Packing GmbH Dresden Dresden

Erweiterungsneubau eines Industriebetriebes mit Labor- und Reinraumtechnik.
- privates Bauvorhaben -

Planung/Realisierung	2006 - 2007
Leistungen nach HOAI	Leistungsphasen: 1-7 Anlagengruppen: 1-5
Kosten	nach TGA: 2.130.000 € gesamt: 3.700.000 €
Bauherr	TLG Immobilien GmbH (NL Süd), Erfurt
Architekt	Christian Meyer-Landrut, Weimar
Bruttogeschossfläche	1.372 m ²



Technische Eckdaten

Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär- und Elektrotechnik

- Reinraum mit US-Reinraumklasse 100 bis 10.000
- 2 Vollklimaanlagen je 6.000 m³/h
- 2 Abluftanlagen je 3.000 m³/h
- 125 kW Kälteanlage (Scrollverdichter-Kältemaschine)
- 340 kW Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung
- 630 kVA Trafostationserweiterung
- Beleuchtungsinstallation Reinnräume und Wartungsbereiche
- komplette Infrastruktur Elektroenergie
- Datennetzwerk (Cat 6)
- flächendeckende Brandmeldeanlage
- Regelungstechnik der Klimaanlagen
- Reinraummedien (DI-Wasser, Vakuum, Stickstoff, Druckluft)
- Reinraumkonstruktion (Raumhülle mit Filter-Fan-Units)

